

### XILINX Cross Reference

XILINX					Ironwood Electronics
Device	Package	Type	Size(mm)	Pitch(mm)	Part#
Spartan-3	VQ100/VQG100	Very-thin Quad Flat Pack (VQFP)	16x16	0.50	-----
	CP132/CPG132	Chip-Scale Package (CSP)	8x8	0.50	SG-BGA-7045
	TQ144/TQG144	Thin Quad Flat Pack (TQFP)	22x22	0.50	-----
	PQ208/PQG208	Plastic Quad Flat Pack (PQFP)	30.6x30.6	0.50	-----
	FT256/FTG256	Fine-pitch, Thin Ball Grid Array (FBGA)	17x17	1.00	SG-BGA-6064
	FG320/FGG320	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	19x19	1.00	SG-BGA-6144
	FG400/FGG400	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	21x21	1.00	SG-BGA-6179
	FG456/FGG456	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	23x23	1.00	SG-BGA-6007
	FG484/FGG484	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	23x23	1.00	SG-BGA-6007
	FG676/FGG676	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	27x27	1.00	SG-BGA-6009
	FG900/FGG900	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	31x31	1.00	SG-BGA-6042
	FG1156/FGG1156	Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA)	35x35	1.00	SG-BGA-6020

注：標準品でヒートシンクが搭載できるソケットはFG676/FGG676のみになります(ヒートシンク付きソケットの型番:SG-BGA-6109)。その他のソケットに関しては、別途ご相談ください。また、QFPパッケージに対応するソケットは、標準品ではご用意しておりません。カスタム作製での対応となりますので別途ご相談ください。

**GAiLOGIC**  
CORPORATION

ガイロジック株式会社

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-35-14

ユニアス七井ビル1階

TEL 0422-28-4500 FAX 0422-28-4501

www.gailogic.co.jp

webinfo@gailogic.co.jp